课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构
- 第二部分: 能带结构
- 第三部分: 热力学统计
- 第四部分: 载流子输运
 - 研究半导体中载流子在外场下的运动; 电阻率
- 第五部分: 非平衡载流子

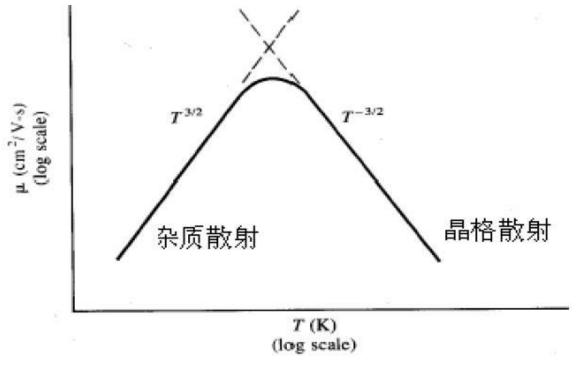
小结: 相关概念

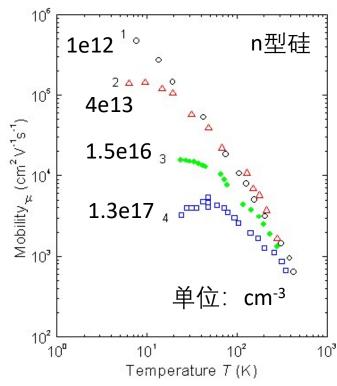
- 散射:单位时间散射概率(次数)P,平均自由 时间τ=1/P
- 迁移率: $|\boldsymbol{v_d}| = \mu |\boldsymbol{E}| = \frac{q\tau}{m^*} |\boldsymbol{E}|$
- 电流密度 $\mathbf{j} = nq \mathbf{v_d}$,电导率 $\sigma = nq \mu$
- 半导体的欧姆定律和电导率
 - $\mathbf{j} = ne\mu_n \mathbf{E} + pe\mu_p \mathbf{E}$
 - $\sigma = ne\mu_n + pe\mu_p$

小结: 影响迁移率的因素

• 非极性半导体中,温度T、电离杂质浓度N_i

$$\mu = \frac{q\tau}{m^*} = \frac{q}{m^*(AN_iT^{-3/2} + BT^{3/2})}$$

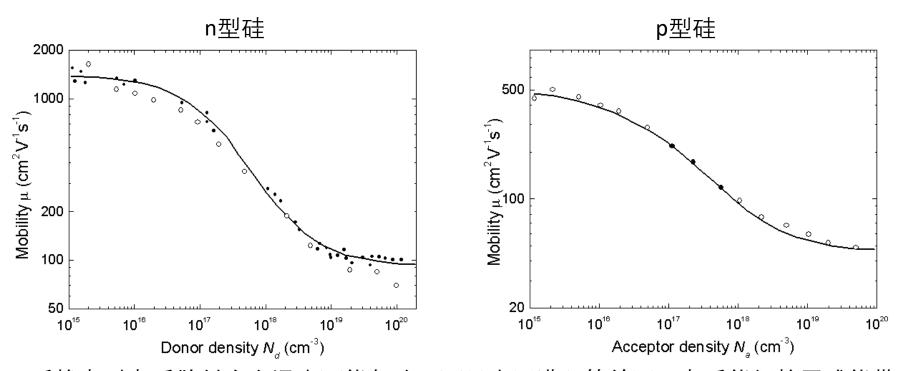




小结: 影响迁移率的因素

• 非极性半导体中,温度T、电离杂质浓度N_i

室温下, 掺杂浓度不太高(<1e17 cm⁻³) , 声子散射为主, 迁移率基本不变



重掺杂时杂质散射在室温也不能忽略。而且由于进入简并区,杂质能级扩展成能带, 相当一部分载流子在杂质能带上运动,有效质量不同

小结: 影响电阻率的因素

- 电阻率和载流子浓度、迁移率有关 $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{ne\mu_n + pe\mu_p}$
- 载流子浓度和温度、掺杂浓度有关(第三章)
- 迁移率也和温度、掺杂浓度有关 $\mu = \frac{q}{m^*(AN_iT^{-3/2} + BT^{3/2})}$
- 因此, 电阻率和温度、掺杂浓度有关
 - 本征半导体随温度 $\rho \propto e^{\frac{Lg}{2k_BT}}$
 - 掺杂半导体随温度
 - 室温, 非简并掺杂半导体

随掺杂浓度
$$\rho = \frac{1}{nq\mu} \propto \frac{1}{N_D} \stackrel{\text{id}}{=} \frac{1}{N_A}$$

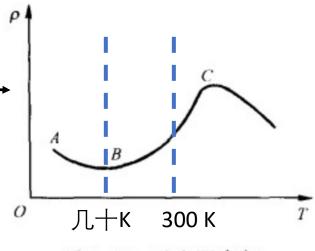
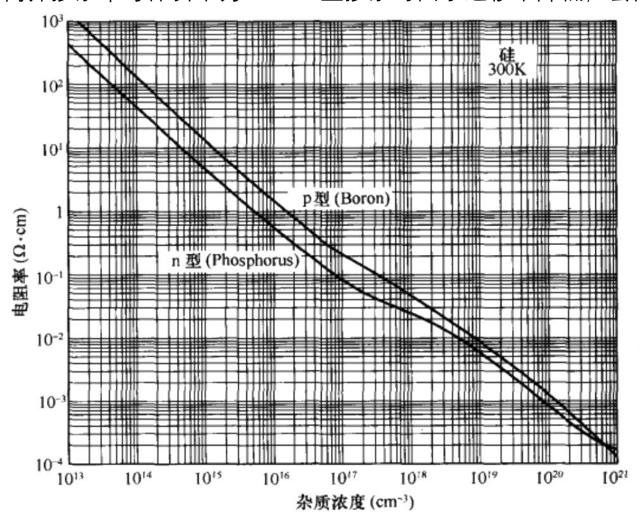


图 4-16 硅电阻率与 温度关系示意图

电阻率和杂质浓度的关系

非简并掺杂半导体斜率为-1

重掺杂时由于迁移率降低, 会向上偏



输运 (transport)

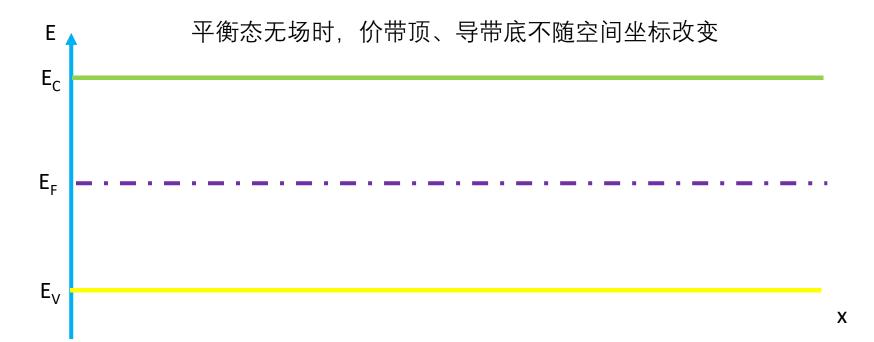
- 输运的定义
 - 载流子的定向运动行为
 - 指载流子产生电流的现象
 - 常见情况是在受到外场(电磁场)作用下产生的运动
- 本章讨论在如下情况下的输运
 - 弱场
 - 热平衡下(定温)、固定掺杂浓度(半导体各处掺杂相同)
 - 强场怎么办?

第四章: 大纲

- 输运、迁移率、散射的概念
 - 载流子的运动(复习第二章)
- 散射机制
 - 杂质散射
 - 晶格振动散射 (声子散射)
- 电阻率、迁移率、散射的关系
- 能带图
- 测量迁移率和电阻率的实验方法

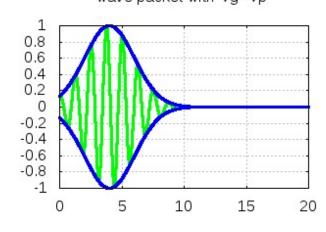
能帶图 (band diagram)

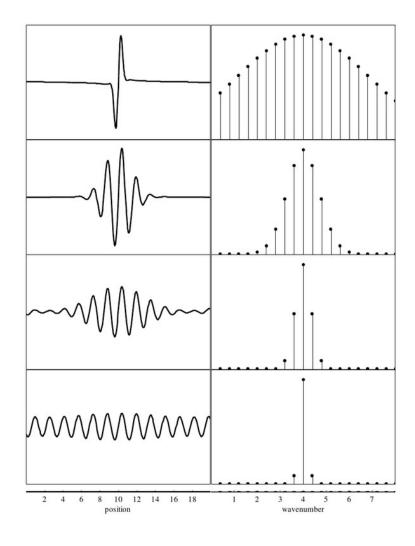
- 显示能带随实空间的变化, 在输运中很有用
- 能带随倒空间(k)的变化是能带结构,两者完全不同



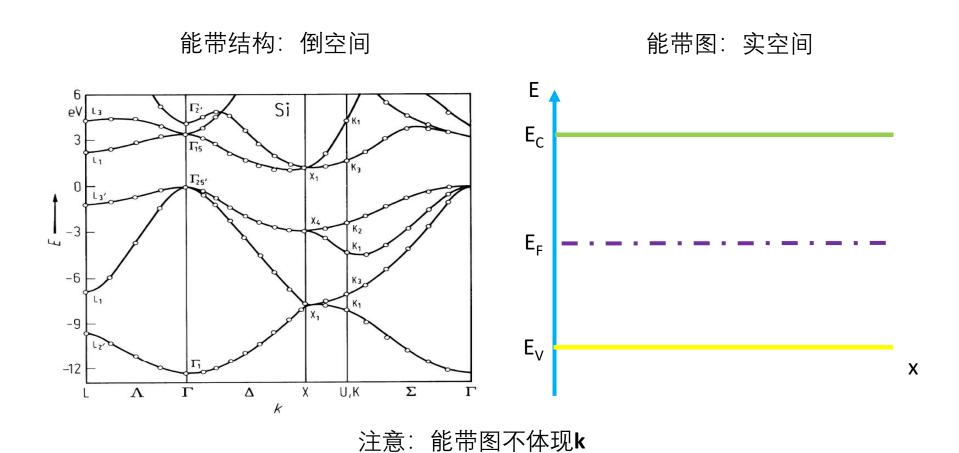
能带图能画是因为准经典近似

- 由于归一化条件,电子波函数会混合相邻波矢的成分,使得存在于晶体所有位置的理想平面波变成局域化的波包("质包")
- 此时,电子可以有类似经典的(平均)位置、速度、加速度 wave packet with Vg<Vp



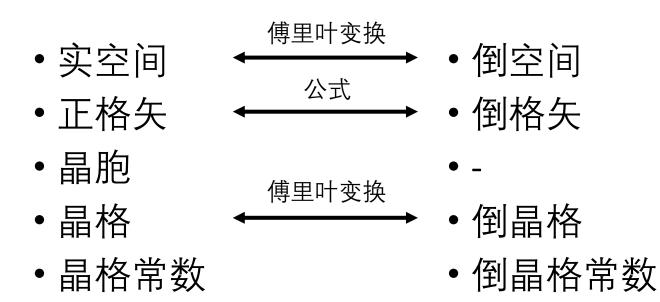


倒空间和实空间



例如,导带底和导带底上方能级波矢不同,但能带图中并不体现这一差异

复习: 概念之间的关系



• 能带图 (E-x)

原胞

• 能带结构 (E-k)

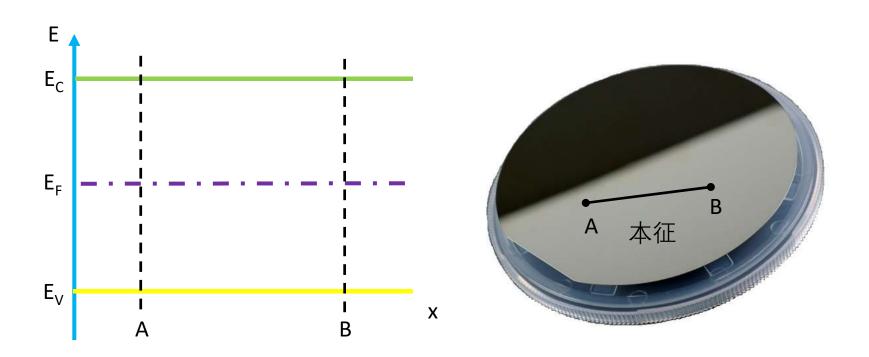
• 布里渊区

复习: 倒空间的意义

- 对晶格进行傅里叶变换成为倒晶格
- 平移矢量:倒格矢 \mathbf{b}_i (\mathbf{i} =1,2,3),和对应脚标不同的正格矢构成的平面垂直
- 倒空间是波矢量k所处的线性空间
- 能带结构E(k)的定义域就位于倒空间中
 - 注意E为能量, E为电场
- 能带图E(x)的定义域位于实空间中

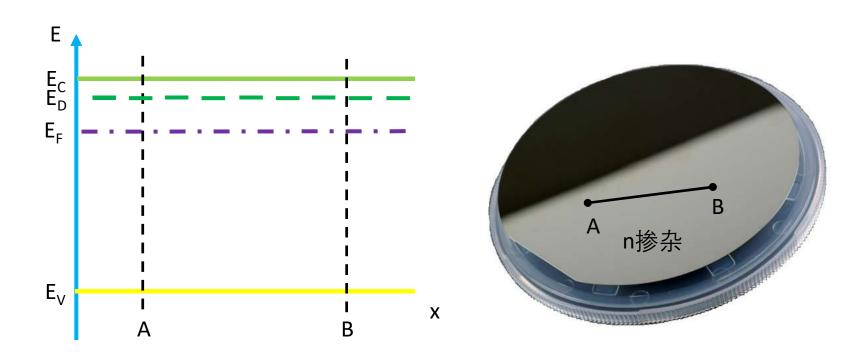
能带图与半导体位置

• 能带图显示半导体能带随半导体位置的变化



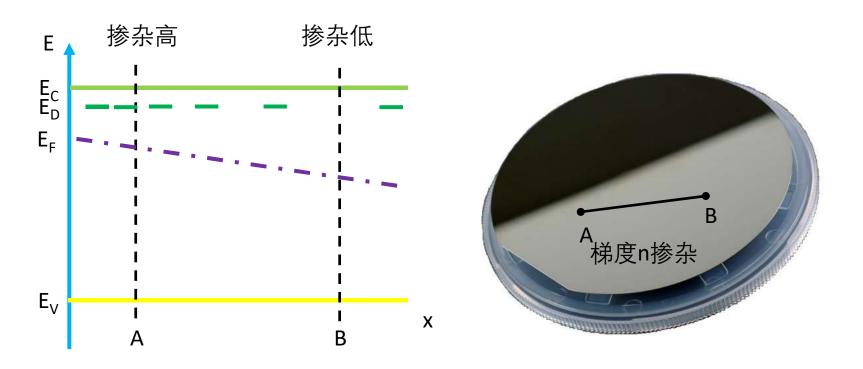
能带图与杂质能级

• 能带图显示半导体掺杂随半导体位置的变化



能带图与杂质能级(非均匀)

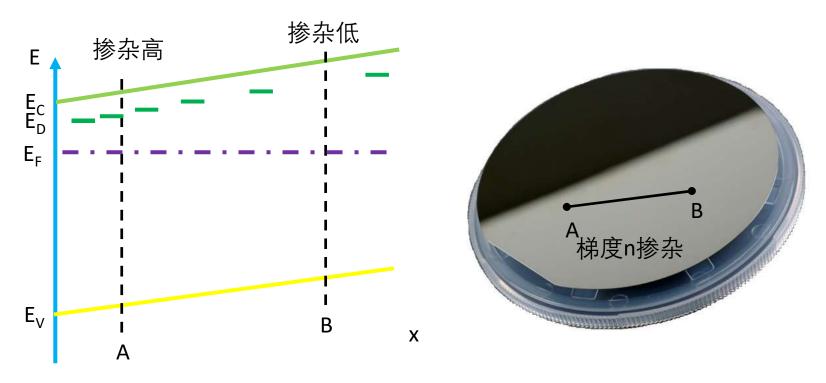
• 能带图显示半导体掺杂随半导体位置的变化



这样对吗?

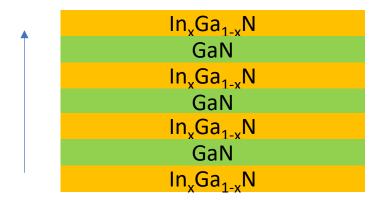
能带图与杂质能级(非均匀)

• 能带图显示半导体掺杂随半导体位置的变化



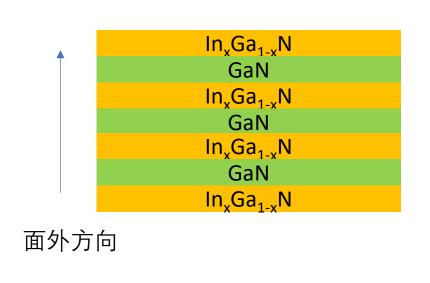
为什么E_F需要一致? 第五章再讲

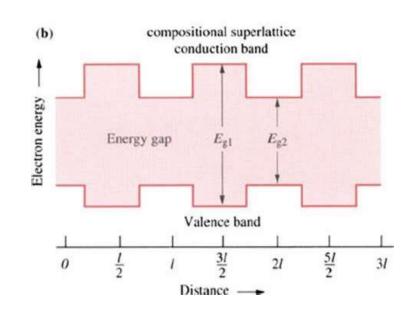
• 激光二极管里通常会用到半导体超晶格(如图)。 以面外方向为横轴,试画出能带图。假设均为本 征半导体,不同半导体E_F全部一致。



面外方向

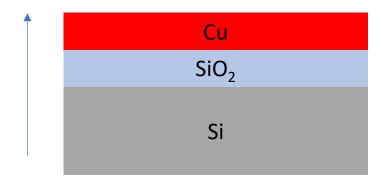
激光二极管里通常会用到半导体超晶格(如图)。
以面外方向为横轴,试画出能带图。假设均为本征半导体,不同半导体E_F全部一致。





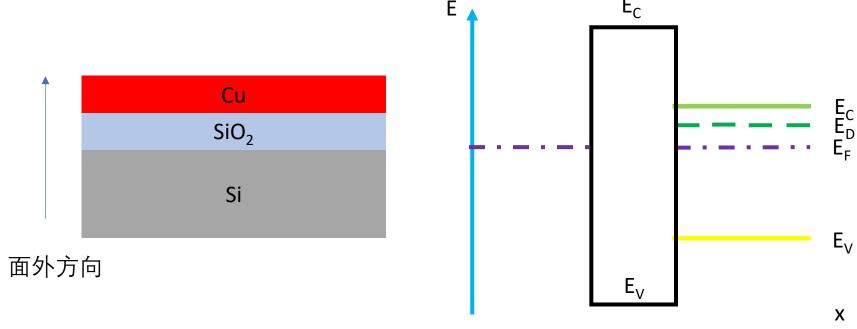
注意: 仅为示意, 有因素尚未考虑, 需先学习第五章

 场效应晶体管里会用到金属-氧化物-半导体 (MOS)结构(如图)。以面外方向为横轴,试 画出能带图。假设Si为n型,E_F全部一致。



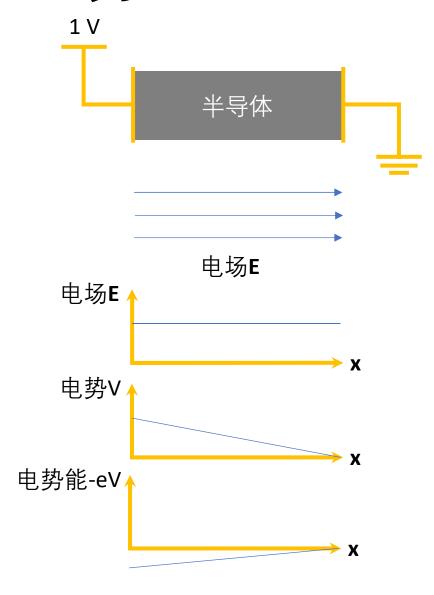
面外方向

• 场效应晶体管里会用到金属-氧化物-半导体 (MOS)结构(如图)。以面外方向为横轴,试 画出能带图。假设Si为n型,E_F全部一致。



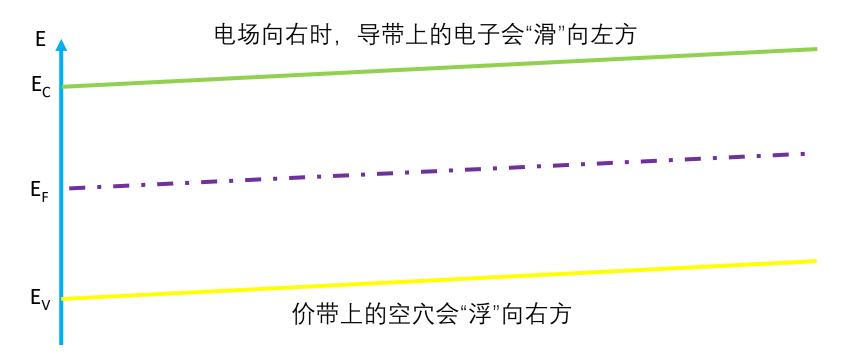
注意: 仅为示意, 有因素尚未考虑, 需先学习第五章

电场和电势



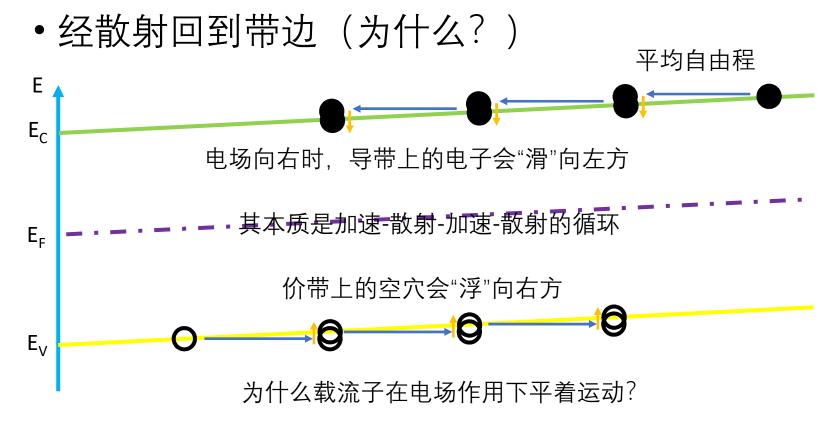
电场中的能带图

- 外加电场**E**后,产生电势V=-**E.x**。电子能量附加 **E**=e**E.x**
- 叠加在能带上即得弱场下的能带图



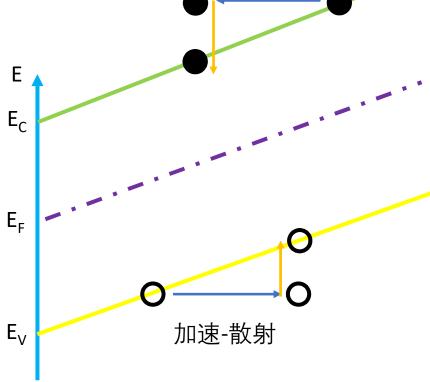
能带图中的散射

- 外加电场E后, 电子加速, 相对于带边能量提高
 - 空穴能量相对于带边也提高, 但表现为"降低"



强场下的能带图

- 外加强电场E后, 能带倾斜很大
- 载流子加速后会脱离带边
- 不再满足费米分布
- 不再处于热平衡
- 不适用之前结论



加速-散射

电子体系的热平衡状态

- 宏观: 温度趋于确定
- 微观: 孤立半导体系统中存在:
 - 载流子<u>产生</u>过程——电子从价带向导带跃迁(产生电子和空穴);或者从杂质能级向导带跃迁(产生电子);或者从价带向杂质能级跃迁(产生空穴)。
 - 载流子<u>复合</u>过程——电子从导带回到价带或杂质能级上; 或者电子从价带回到杂质能级。
 - 对每个能级,产生数 = 复合数,即热平衡状态
- 不满足上述条件,或半导体系统存在外部作用如 外加**电压**、光照、辐射等,则处于非平衡状态

强场下欧姆定律的失效

当E很强时,欧姆定律 $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ 不再适用,因为 $|\mathbf{v_d}| = \mu |\mathbf{E}|$ 不再适用

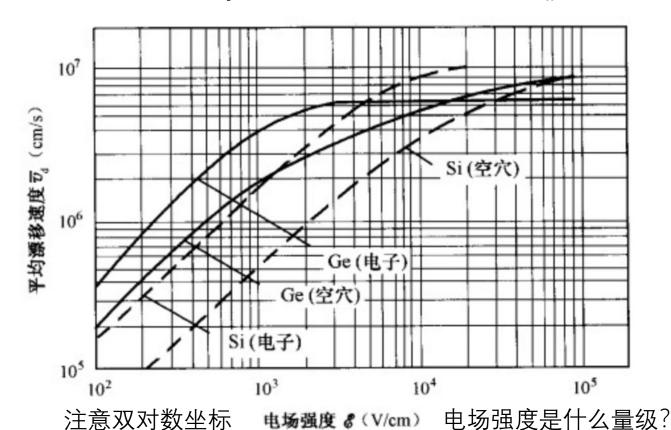


图 4-17 锗、硅的平均漂移速度与电场强度的关系 (300K)

漂移速度的饱和

- 又称"速度饱和效应"
 - 一般而言,当外电场< 10³-10⁴ V/cm,可认为迁移率是 常数
 - 外电场> 10³-10⁴ V/cm的强电场下,迁移率随电场增加而降低,漂移速度与电场强度不再成正比,直至漂移速度趋向饱和→欧姆定律发生偏离
- 一个100 μm的器件(假设工作电压1 V)属于强 场吗? 100 nm呢?
- 原因:强电场下,散射增加,迁移率和电导率不再是常数(散射概率与电场有关)

用非平衡态解释强场效应

- 无外加电场,载流子与晶格处于热平衡
- 当存在外加电场,载流子从电场获得能量。到达稳态后,单位时间内载流子从电场获得的能量=载流子给予晶格的能量
 - 弱电场下, 到达稳态后, 仍可认为载流子与晶格仍达到热平衡, 电子的平均能量可认为不变, 迁移率为常数
 - 强电场下,载流子的平均动能显著超过热平衡时的平均动能一热载流子 (等效温度T_e)

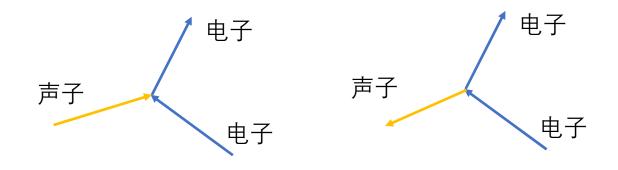
热载流子(hot carrier)

- 热载流子是指能量高于系统(由温度而附加的) 内能k_BT的载流子,主要是部分载流子在强电场 作用下,获得很高能量的物理效应
- 热载流子受到更强的晶格散射,迁移率随电场增加而降低,以至漂移速度达到饱和
 - 可认为电子等效温度T_e更高。由于热运动越剧烈越容易撞到声子,因此迁移率下降

声子的吸收和发射

- 弱场下,电子主要吸收发射长波声子,发生弹性散射
- 强场下热电子能量高,也可发射短波声子造成非弹性散射

晶格振动散射



声子: 局域化的晶格振动, 可带电(极性光学 支)或不带电(其它)

热载流子和速度饱和

- 当电场较强时,电子等效温度T_e更高。由于热运动越剧烈越容易撞到声子,因此迁移率下降
- 当电场更强时,散射时可发射高能光学声子,电 子很容易失去所获得的能量,微分迁移率为零, 漂移速度可达到饱和

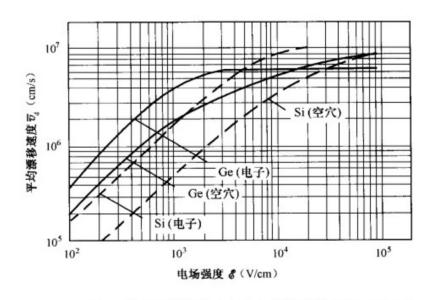


图 4-17 锗、硅的平均漂移速度与电场强度的关系(300K)

高场下的负微分电导

某些半导体在高场下会出现漂移速度随电场下降的情况

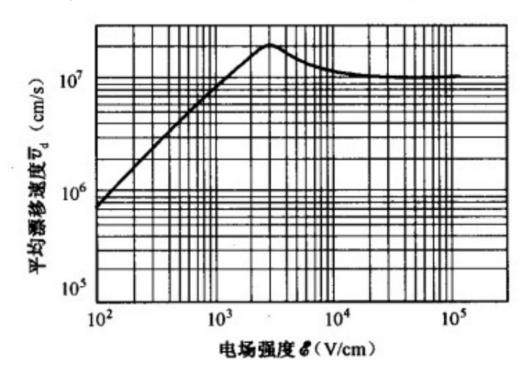


图 4-20 砷化镓电子平均漂移 速度与电场强度的关系(300K)

高场下的负微分电导

- GaAs等半导体在高场下会出现漂移速度随电场下降的情况
- 即 $d|\boldsymbol{v_d}|/d|\boldsymbol{E}| < 0$
- $|v_d|/|E|$ 为迁移率, $d|v_d|/d|E|$ 称为"微分迁移率"
- |j|/|E|为电导率,d|j|/d|E|称为"微分电导率"
- 因此又称为高场下的负微分电导

多能谷散射

- GaAs的导带存在三类能谷: ΓX、L、Γ, Γ最低, L次低
- Γ能谷的有效质量比L能谷小(比较GaAs有效质量 0.06m @Γ, Ge有效质量 1.64/0.08m @L)
- 「能谷的迁移率比L能谷大

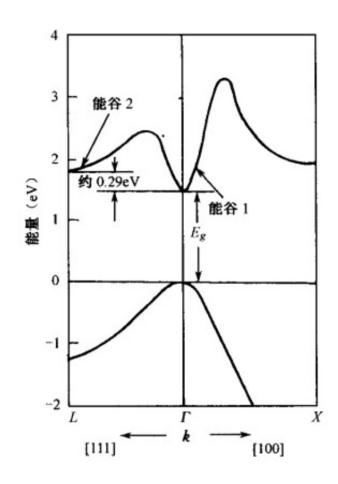


图 4-19 砷化镓能带结构

多能谷散射和负微分电导

- 当温度不太高、电场不太强时,导带电子绝大部分位于Γ能谷
- 当样品中的电场足够强,可形成热电子,发射一个声子,产生能谷间的散射

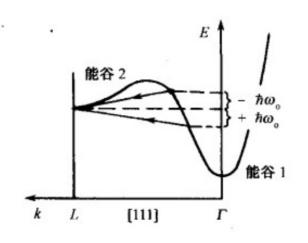


图 4-21 能谷间散射示意图

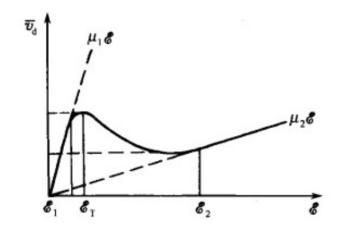


图 4-22 vd 与6的关系

多能谷散射和负微分电导

- 「能谷中的电子散射进入L能谷,有效质量上升, 迁移率下降
- 电导率下降,产生负微分电导
 - 更高场时, 电子发射高能声子损失能量, 漂移速度又 达到饱和

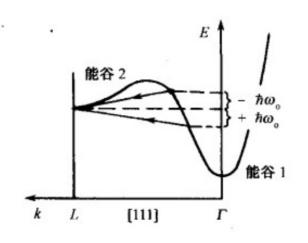


图 4-21 能谷间散射示意图

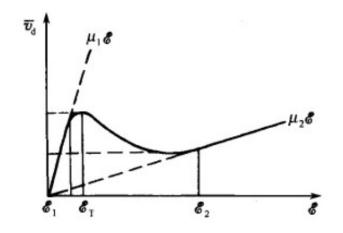


图 4-22 vd 与6的关系

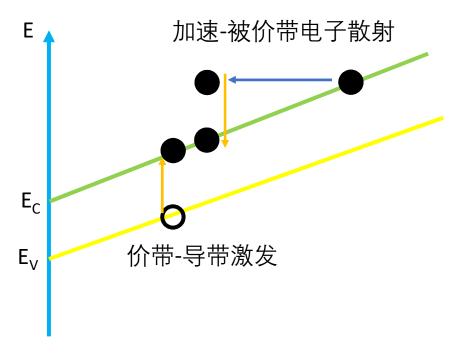
击穿 (breakdown)

- 极强场; 一般量级为10⁶ V/cm
- 由于大量产生载流子而电导率急剧增加,电流急剧上升
 - 可能导致半导体烧毁
- 有些可逆有些不可逆

击穿: 雪崩

- 极高场下的热载流子有可能导致:
 - 发生碰撞电离, 引起载流子数目的突然增加
 - 半导体电导率急剧增加, 电流急剧上升

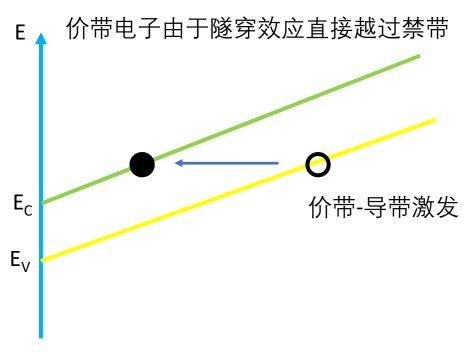
碰撞电离引起载流子数目的突然增加



击穿: 隧穿

- 极高场下的热载流子有可能导致:
 - 电子从价带越过禁带进入导带, 载流子数目突然增加
 - 半导体电导率急剧增加, 电流急剧上升

隧穿引起载流子数目的突然增加

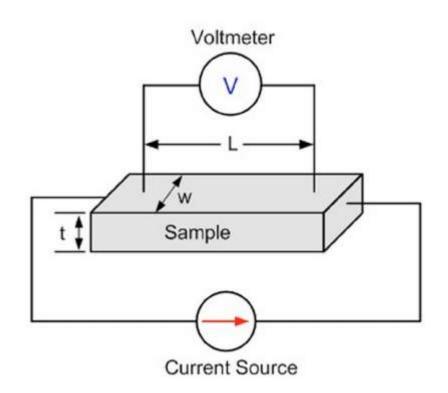


这些理论如何用实验验证?

第四章: 大纲

- 输运、迁移率、散射的概念
 - 载流子的运动(复习第二章)
- 散射机制
 - 杂质散射
 - 晶格振动散射 (声子散射)
- 电阻率、迁移率、散射的关系
- 能带图
- 测量迁移率和电阻率的实验方法

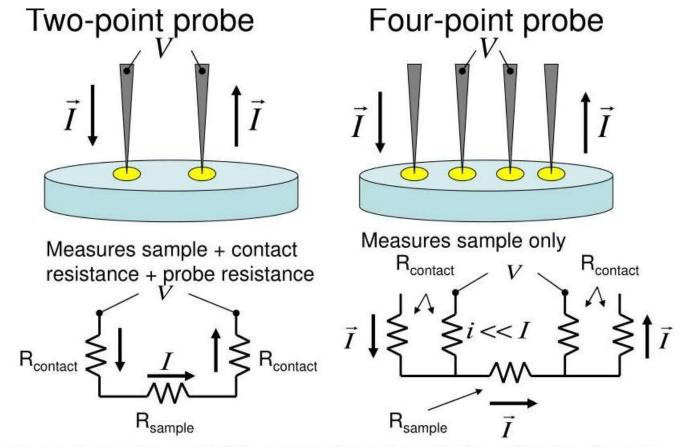
电阻率:实验测量



利用欧姆定律V=IR测量电阻R, 然后用R=ρL/wt计算电阻率

电阻率:实验测量

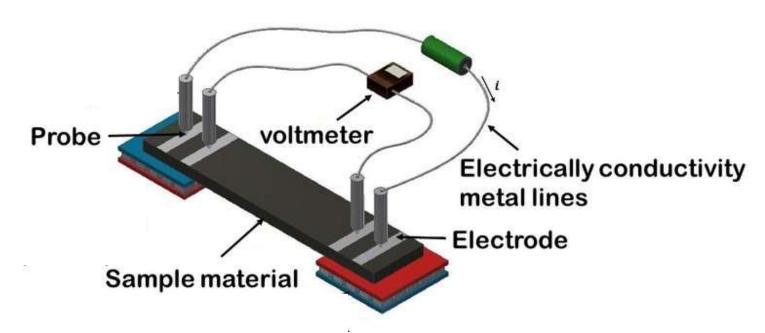
四端法准确测量电阻



In four-point probe, negligible current flows through the voltmeter, the only voltage drop measured is across R_{sample} .

电阻率:实验测量

四端法准确测量电阻: 保持电流密度均匀

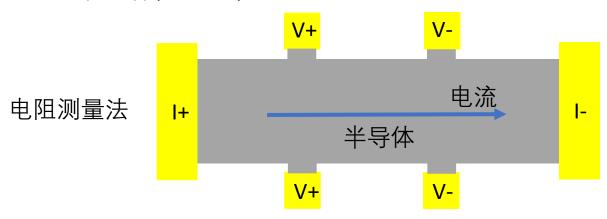


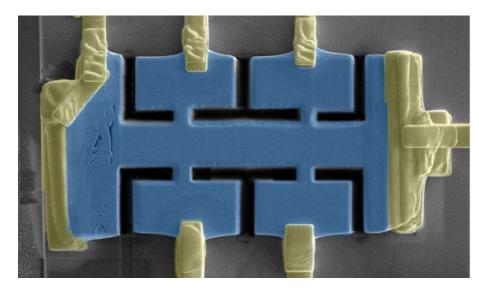
迁移率: 实验测量

- 迁移率直接测量比较麻烦
- 利用 $\sigma = nq\mu$ 计算
 - 测量电阻率 (电阻测量)
 - 测量载流子浓度(霍耳效应)

迁移率: 实验测量

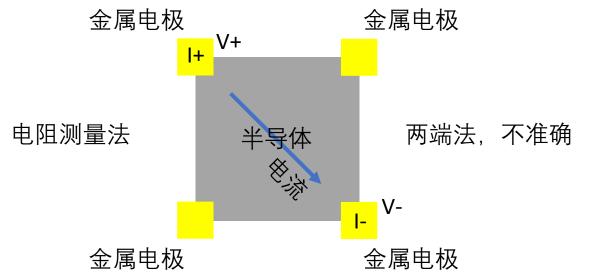
霍耳棒(Hall bar)测量法:同时测量电阻率和载流子浓度

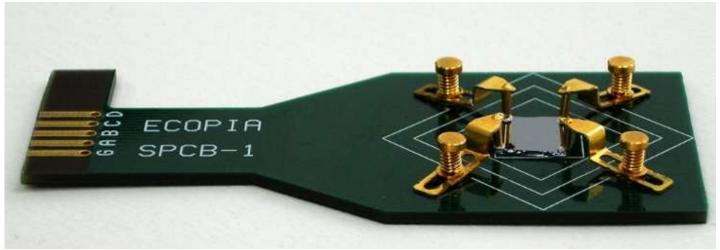




迁移率: 实验测量

范德坡(van der Pauw)测量法:同时测量电阻率和载流子浓度





- 1.本征硅室温的载流子浓度约为 n_i = 1e10 cm⁻³。 已知电子迁移率为1500 cm²/Vs,空穴迁移率为500 cm²/Vs,求它的电阻率。
- 2.在实验室中发现一片硅,标明砷掺杂,电阻率为1-10 Ohm.cm。迁移率可查表。求载流子浓度。
- 3.砷化镓室温电子迁移率约为8000 cm²/Vs, 空穴迁移率约为400 cm²/Vs; 电子有效质量约0.06m, 空穴有效质量约0.50m。求两种载流子的平均自由时间。

- 4.硅中掺杂了1e16 cm⁻³的硼, 300 K时迁移率约 为500 cm²/Vs。试估算其在200 K时的电阻率。注 意判定200 K时是否还在饱和电离区。
- 5.硅的重空穴有效质量为m*_{ph}=0.53m, 轻空穴有效质量为m*_{pl}=0.16m。假设两者室温下平均自由时间相同,为τ_p=150 fs, 试推出硼掺杂的硅(饱和电离区)迁移率的表达式和数值。是否可以由此定义价带的电导有效质量?提示:请先计算轻重空穴各有多少。

- 6.有一硅基晶体管,可认为器件区(沟道)长宽厚各为100、20、20 nm。在开启后,沟道电子浓度为1e16 cm⁻³,迁移率1000 cm/Vs。现在在长端(源漏)加上3 V电压,不考虑强场效应,求源漏电流。
- 7.设电子、空穴迁移率不等。证明: 对于非简并半导体,当 $n = n_i \sqrt{\mu_p/\mu_n}$ 、 $p = n_i \sqrt{\mu_n/\mu_p}$ 时,电导率最小,并求出它的表达式。

• 8.有一片未知半导体(100 μm厚度),加上向右的电流I=1 mA和垂直于纸面向里的磁场B=20 Oe后,观察到上正下负的电压3.2 mV,左正右负的电压2 V(长宽比2.5:1)。求载流子迁移率。

